

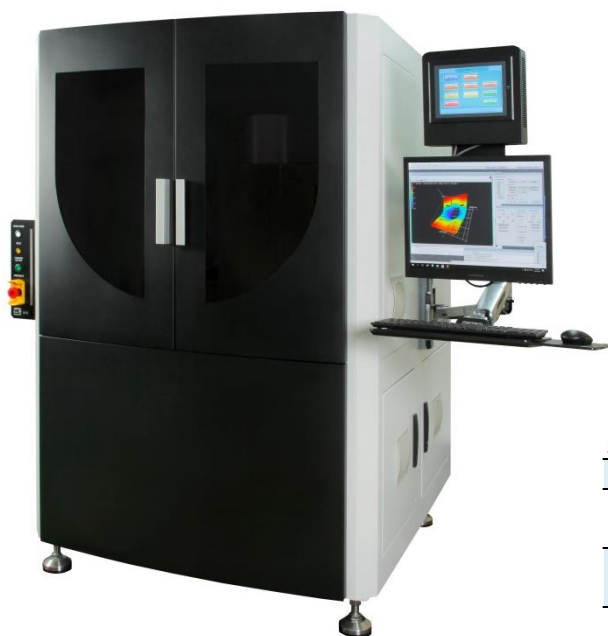
# A Leading Company of 3D Inspection System

## 高速・高精度 三次元検査装置

永年にわたって培われた、東光高岳独自の共焦点方式三次元センサーが、  
日夜進化する高密度実装分野の計測ニーズにお応えします

# 広視野温度可変反り検査装置

## HVI-S10000C



広視野・高精度計測

バンプ除去、

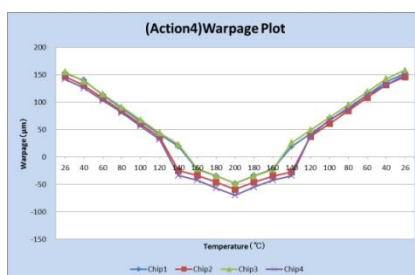
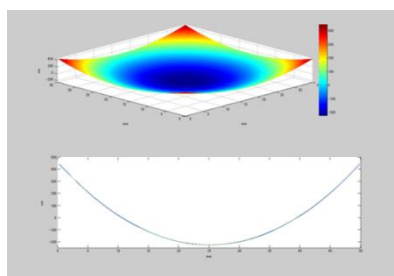
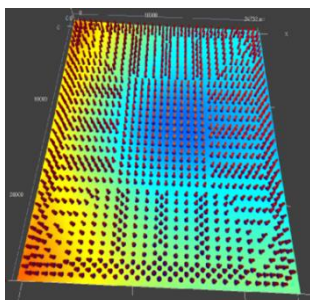
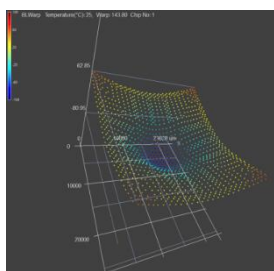
塗装処理不要

計測範囲 160×136 mm

マイナス温度も対応

### 装置仕様 Specification

	HVI-S10000C-RC	HVI-S10000C-EC
主な用途 Main Use	リフローシミュレーション Reflow Simulation	環境試験 Environmental Test
加熱方式 Heating System	対流方式 Convection	
温度制御範囲 Temperature Range	20°C ~ 300°C	-55°C ~ 260°C *Target
計測方式 Measurement System	リニア走査型共焦点 Linear Scanning Confocal	
計測視野サイズ FOV Size	41×33mm	
計測範囲 Measurement Range	160×136mm	
計測速度 Measurement Speed	約2秒/視野 (Z軸計測範囲: 1mmの場合) About 2s/FOV (1mm Z Measurement Range)	
Z計測範囲 Z Measurement Range	最大4mm Max.	
XY分解能 XY Resolution	11.0μm	
Z分解能 Z Resolution	0.1μm	
装置サイズ Tool Size	(W)1,200×(D)1,400× (H)1,900mm	-



株式会社 東光高岳  
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

## EVI-S10210-RA 次世代基板向け検査装置

本装置は、トレイ(JEDEC)搬送された次世代基板を治具上へ移載し、高速・高精度に検査することが可能です。また、2シャトル方式のワーク搬送やZ範囲を最適化するシステムを採用しており高スループットを実現しました。



装置仕様 Specification

主な検査項目 Main Inspection Item	Bump Height , Bump Diameter Bump Coplanarity , Substrate Warpage
計測視野サイズ FOV Size	15×15mm
Z計測範囲 Z Range	60~300μm (Variable)
XY分解能 XY Resolution	3.0μm
Z分解能 Z Resolution	0.1μm
処理速度 Throughput	1,000UPH (C4エリア28×28mm、Z計測範囲144μm)

## TVI-S10210-RA インラインバンプ検査装置 In-Tray Type

本装置は、個片状態のパッケージ基板をトレイ(JEDEC)に収納した状態で、高速・高精度に検査することが可能です。バンプ形状は、ラウンド、フラッタニングどちらも計測可能です。



装置仕様 Specification

主な検査項目 Mail Inspection Item	Bump Height Bump Coplanarity , C4 Area Warpage
計測視野サイズ FOV Size	13×13mm , 11×15mm , 15×11mm
Z計測範囲 Z Range	約240μm
XY分解能 XY Resolution	約3.0μm
バンプ径(最小) Bump Diameter (Min.)	25μm
バンプピッチ Bump Pitch	≧55μm
計測繰り返し精度(高さ) Accuracy In Height	3σAVE+3σ3σ≦2μm
装置サイズ Tool Size	(W)3,020 × (D)2,245 × (H)1,800 (参考)